



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E  
INOVAÇÃO**

**CONSULTA PÚBLICA Nº 40- SEI, 01 DE SETEMBRO DE 2021**

O Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico – PPB de **TERMINAL PORTÁTIL DE TELEFONIA CELULAR**.

O texto completo está disponível no sítio da Secretária de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, no endereço:

<https://www.gov.br/produktividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/consultas-publicas-de-ppb-1/consultas-publicas-de-ppb-2021>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: [cgel.ppb@economia.gov.br](mailto:cgel.ppb@economia.gov.br), [cgct.ppb@mctic.gov.br](mailto:cgct.ppb@mctic.gov.br) e [cgpri.ppb@suframa.gov.br](mailto:cgpri.ppb@suframa.gov.br).

**JORGE LUIZ DE LIMA**

Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação

## ANEXO

### PROPOSTA Nº 024/21 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA TELEFONE CELULAR, ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS SEPEC/ME/MCTIC nº 2 e nº 3, de 21.06.2019.

1) Os incisos IV, X e XIII da tabela de pontuação, constante no art. 1º das Portarias Interministeriais SEPEC/ME/MCTIC nº 2 e nº 3, de 21 de junho de 2019, passam a ser os seguintes:

**DE:**

<b>Inciso</b>	<b>Etapas Produtivas</b>	<b>Pontos Totais</b>
IV	Corte do <i>wafer</i> , encapsulamento e teste dos Processadores Principais ou corte do substrato, encapsulamento e teste dos Componentes Semicondutores de Alta Integração <i>System in Package</i> com função de Processamento (CPU).	11
X	Laminação das placas de circuitos impressos que implementem a função de processamento central.	1
XIII	Corte, decapagem, crimpagem ou soldagem dos cabos de dados.	4

**PARA:**

<b>Inciso</b>	<b>Etapas Produtivas</b>	<b>Pontos Totais</b>
IV	Corte do <i>wafer</i> , encapsulamento e teste dos Processadores Principais ou corte do substrato, encapsulamento e teste dos Componentes Semicondutores de Alta Integração <i>System in Package</i> com função de Processamento (CPU).	9
X	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuitos impressos que implementem a função de processamento central.	1
XIII	Corte, decapagem, crimpagem ou soldagem dos cabos de dados.	6

2) A pontuação das demais etapas produtivas, bem como a pontuação total e a meta permanecem com os mesmos valores.

3) As alterações propostas neste PPB passarão a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2022.